

苏州天沃科技股份有限公司 关于前期借款合同的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）分别于 2018 年 8 月 21 日、2018 年 8 月 29 日与上海电气集团股份有限公司（包括其下属公司及其关联方，以下统称“上海电气”）签订《借款合同》及相关附属合同。合同约定，公司向上海电气借款，金额共计人民币 20 亿元。就上述借款，公司分别于 2019 年 2 月 22 日、2020 年 2 月 22 日、2021 年 1 月 29 日、2022 年 1 月 28 日与上海电气签订《借款展期协议》，其中 13 亿元《借款展期协议》和 7 亿元《借款展期协议》借款期限分别将于 2023 年 2 月 21 日和 2023 年 2 月 28 日到期。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日、2018 年 8 月 31 日、2019 年 2 月 26 日、2020 年 1 月 23 日、2020 年 2 月 11 日、2020 年 2 月 25 日、2021 年 1 月 30 日、2021 年 2 月 2 日和 2022 年 1 月 29 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司已全额归还了上述借款的本金与利息。本次还款不会对公司的经营业绩产生不利影响。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日